

AIDC: 人工智能发展的核心引擎

证券研究报告 2025 年 05 月 25 日

产业赛道投资图谱

AIDC 总览: 人工智能发展的核心引擎

AIDC 是基于人工智能计算架构构建的算力基础设施,通过融合高性能计算设备、高速网络以及先进软件系统,为人工智能训练和推理提供高效、稳定的计算环境。AIDC 的政策支持呈现三大特征:一是多部门协同推进,二是全周期覆盖,三是技术自主化导向。在大模型发展热潮带来的需求推动下,智算中心市场规模持续扩大。根据科智咨询测算,2023-2028中国智算中心市场规模年化增速超25%。

AIDC 行情复盘: 从新基建政策红利到 AI 竞争带来的需求兑现

AIDC 为算力基建的核心载体,在 2018-2025 年间呈现三轮显著超额收益行情: 政策驱动阶段 (2019.1.3-2020.7.14): 此轮行情核心催化来自于国家新型基础设施建设的体系化推进,算力基础设施累计涨跌幅+110%,相对全 A涨跌幅+41%。技术政策共振阶段 (2022.10.20-2023.4.25): 此轮行核心催化来自于 AI 技术突破和政策共振,算力基础设施累计涨跌幅+50%,相对全 A涨跌幅+39%。AI 大模型迭代突破阶段 (2024.2.5-2025.2.26): 此轮行情核心催化来自于大模型的激烈竞争带来的算力需求显著提升。

AIDC 产业链全景图谱

- 1) AI 计算芯片: GPU 主导 AI 计算芯片市场,国产替代加速。在 AI 计算芯片领域,主要技术架构可划分为 GPU、FPGA 和 ASIC。从产业规模维度观察,GPU 当前占据国内 AI 计算芯片的主导地位,市场份额高达约 90%。在美国对华高端计算芯片出口管制持续升级与国内人工智能产业快速发展的双重驱动下,国产计算芯片产业正迎来战略性发展机遇。
- 2)存储芯片: 支撑数据存算协同的核心硬件,技术升级与国产化替代进行时。 存储芯片中 DRAM 与 NAND 闪存构成存储芯片的"双支柱"。随着 AI 大模型 训练对高带宽存储的需求激增,叠加智能终端边缘推理对高容量存储的拉动, 存储芯片市场进入复苏通道。存储芯片作为支撑数据存算协同的核心硬件, 其技术升级与国产化替代已成为关键投资主线。
- 3) 供配电: AI 算力需求激增驱动电源设备升级机遇。供电系统是数据中心的关键性基础设施,相当于数据中心的"心脏",供配电系统故障不仅会导致数据无法储存和读取,甚至还会导致服务器宕机等故障,造成数据丢失与损坏。AI 算力需求激增倒逼智算中心供配电系统向集约化、模块化和预制化发展,可关注机柜外电源,柴油发电机,备用电源,变压器等细分领域。
- 4) 网络: 算力基建向多机多卡发展,高性能网络决定通信效率。算力基础设施硬件架构向多机多卡发展,高性能网络决定集群通信效率。多机多卡分布式训练技术已成为行业标配,而该技术的有效运行需构建具备超强计算与显存能力的集群作为硬件底座。在此架构中,联接算力节点的高性能网络直接决定了集群通信效率,进而影响整体吞吐量和算力利用率。可关注光通信&CPO、AEC&铜连接及交换机等细分领域。
- 5)制冷:单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要选择。芯片算力提升驱动算力中心单机功率密度持续攀升,高功率的服务器和IT设备产生的热量不断增加,液冷技术凭借其高效热传导特性将成为主要散热方式选择。当前冷板式液冷路线占据主流,浸没式液冷路线有望逐步成为技术演进的主流方向。可关注液冷相关供应商。

风险提示:产业发展进程不及预期;政策出台和落地具备不确定性;宏观经济波动。

作者

吴开达 分析师 SAC 执业证书编号: S1110524030001

wukaida@tfzq.com

肖峰 分析师 SAC 执业证书编号: \$1110524040003 xiaofeng@tfzq.com

相关报告

- 1 《投资策略:投资策略-微观流动性 跟 踪 (2025.5.5-2025.5.18) 》 2025-05-21
- 2 《投资策略: 做强国内大循环-政策与大类资产配置周观察》 2025-05-20 3 《投资策略: 中观景气度高频跟踪及

运用-中观景气度数据库和定量模型应

用》 2025-05-19



内容目录

1. AIDC 总览: 人工智能发展的核心引擎	4
2. AIDC 行情复盘: 从新基建政策红利到 AI 竞争带来的需求兑现	8
3. AIDC 产业链全景图谱	10
3.1. AI 计算芯片: GPU 主导 AI 计算芯片市场,国产替代加速	10
3.2. 存储芯片: 支撑数据存算协同的核心硬件,技术升级与国产化替代进行	时12
3.3. 供配电: AI 算力需求激增驱动电源设备升级机遇	14
3.4. 网络:算力基建向多机多卡发展,高性能网络决定通信效率	16
3.5. 制冷: 单机功率密度攀升驱动散热系统升级, 液冷技术有望成为数据中选择	
4. 风险提示	20
图表目录	
图 1: AIDC核心构成包括计算设备、存储设备、网络设备、供配电系统和制冷	系统4
图 2: AIDC的政策支持呈现三大特征:一是多部门协同推进,二是全周期覆盖,自主化导向	
图 3: 在大模型发展热潮带来的需求推动下,智算中心市场规模持续扩大	7
图 4:按算力规模来看,互联网及云厂商占据重要地位,其占比约 35%,其次为运营商,占比约 26%,地方政府则占比约 14%	
图 5: 智算中心建设主体多样,功能诉求有别	7
图 6: 智算中心以多层次服务体系覆盖全产业链需求,形成四大核心商业模式	8
图 7: AIDC 在 2018-2025 年间呈现三轮显著超额收益行情	9
图 8:在人工智能计算芯片领域,主要技术架构可划分为图形处理器 (GPU)、现门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC) 三大类别	
图 9: GPU 主导中国 AI 计算芯片市场	11
图 10: 2025 年中国 GPU 市场规模约 1200 亿元	11
图 11: 2025 年中国 FPGA 市场规模预计超 300 亿元	11
图 12: 2025 年中国 ASIC 市场规模预计超 20 亿美元	11
图 13: AI 计算芯片: GPU 主导 AI 计算芯片市场,国产替代加速	11
图 14:存储芯片包括易失性存储和非易失性存储两大类,DRAM 与 NAND 闪花芯片的"双支柱"	
图 15: 24-25 年中国存储市场规模增速将回暖	13
图 16:存储芯片市场以 DRAM 和 NAND 为主	13
图 17: 预计 24 年全球 DRAM 市场规模增速回暖	13
图 18: 预计 24 年全球 NAND Flash 市场规模增速回暖	
图 19. 存储芯片: 支撑数据存算协同的核心硬件,技术升级与国产化替代进行	
图 20:数据中心供配电系统示意图	
图 21: 供配电: AI 算力需求激增驱动电源设备升级机遇	
图 22: 高性能网络需要具备低时延、高带宽、长期稳定性、大规模扩展性和可能	医维等关键
能力	16

策略报告 | 投资策略专题



图 23:	InfiniBand 和 RoCE 网络解决方案特点对比	16
图 24:	网络: 算力基建向多机多卡发展,高性能网络决定通信效率	17
图 25:	数据中心冷却方式	18
图 26:	冷板式液冷路线占据国内主流,浸没式液冷路线有望逐步成为技术演进的主流方	
图 27: 择	制冷:单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要	选 19

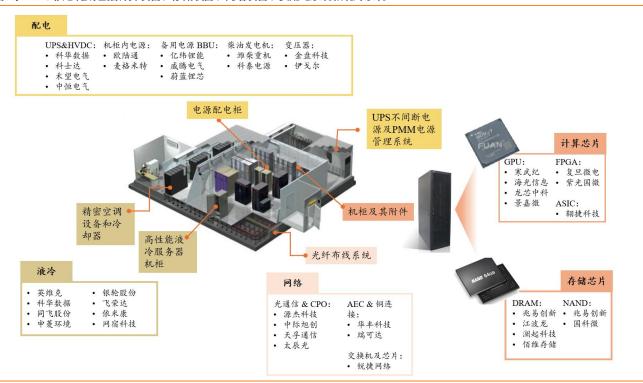


1. AIDC 总览: 人工智能发展的核心引擎

AIDC是基于人工智能计算架构构建的算力基础设施,通过融合高性能计算设备、高速网络以及先进软件系统,为人工智能训练和推理提供高效、稳定的计算环境。**其核心构成主要包括计算设备、存储设备、网络设备、供配电系统和制冷系统。**其核心功能有提供算力服务、高效数据服务及 AI 应用支持:

- 1)提供强大的计算能力:智算中心采用专门的 AI 算力硬件,如 GPU、NPU、TPU 等,以支持高效的 AI 计算任务。
- 2)高效的数据处理:智算中心融合了高性能计算设备和高速网络,能够处理大规模的数据集和复杂的计算任务。
- 3) 支持多种 AI 应用:智算中心适用于计算机视觉、自然语言处理、机器学习等领域,处理图像识别、语音识别、文本分析、模型训练推理等任务。

图 1: AIDC 核心构成包括计算设备、存储设备、网络设备、供配电系统和制冷系统



资料来源: Wind, 灼识咨询, 天风证券研究所



AIDC 的政策支持呈现三大特征:一是多部门协同推进,二是全周期覆盖,三是技术自主 **化导向。**我国自 2017 年起从顶层设计到细分领域持续强化对人工智能数据中心(AIDC) 的政策支持,逐步构建起覆盖技术研发、基础设施布局、算力服务优化的完整体系。2017 年国务院《新一代人工智能发展规划》首次提出布局人工智能超级计算中心,为 AIDC 的 顶层设计奠定基础。2020年国家发改委明确将智能计算中心纳入新基建范畴, AIDC成为 国家数字化底座的核心构成。此后,政策进一步细化: 2021年《新型数据中心发展三年行 动计划》提出引导新型数据中心集约化、高密度化、智能化建设,逐步提高自主研发算力 的部署比例。同年《"十四五" 国家信息化规划》提出加强高价值专利培育,构建云网融 合的新型算力设施,统筹建设面向区块链和人工智能等的算力和算法中心。2022 年政策聚 焦应用落地与成本优化,科技部等部委提出"低成本算力服务"目标,引导超算中心、智 能计算中心向企业开放资源,降低创新门槛。2023年国务院发布《数字中国建设整体布局 规划》,提出引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布 局。2024 年政策强调优化布局和全产业链生态建设,《关于推动新型信息基础设施协调发 展有关事项的通知》提出优化布局算力基础设施,引导面向全国、区域提供服务的大型及 超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署,逐步提升智能算力占比,东 部发达地区先行先试。发改委等部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》, 提出支持企业参与算力全产业链生态建设,构建一体化高质量算力供给体系。总体而言, AIDC的政策支持呈现三大特征:一是多部门协同推进,国务院、发改委、工信部、网信办 等部门均出台相关支持和引导政策,形成跨领域政策合力;二是全周期覆盖,从基础研究、 设施建设到场景应用层层深入;三是技术自主化导向,强调 CPU/GPU 异构算力自主研发, 强化产业链安全。



图 2: AIDC 的政策支持呈现三大特征: 一是多部门协同推进,二是全周期覆盖,三是技术自主化导向

时间	发文单位	政策/会议名称	主要内容
2017.8	国务院	《新一代人工智能发展规划》	布局前沿基础理论研究,建立新一代人工智能关键共性技术体系,绕 筹布局人工智能创新平台,建立人工智能超级计算中心、大规模超级 智能计算支撑环境等
2020.4	国家发改委	国家发改委新闻发布会	首次明确"新基建"范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面,信息基础设施包括以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等
2021.1	国务院	《建设高标准市场体系行动方案》	加大新型基础设施投资力度,推动第五代移动通信、物联网、工业互 联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础 设施,数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设
2021.7	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》	加快提升算力算效水平,引导新型数据中心集约化、高密度化、智能化建设,稳步提高数据中心单体规模、单机架功率,加快高性能、智能计算中心部署,推动 CPU、GPU等异构算力提升,逐步提高自主研发算力的部署比例,推进新型数据中心算力供应多元化,支撑各类智能应用,强化标准支撑引领,加快推进边缘数据中心、智能计算中心等标准建设,支撑新技术新应用落地
2021.12	中央网络安全和信息化委员 会	《"十四五" 国家信息化规 划》	加强信息技术专利创新, 围绕大数据中心、智能计算中心等领域加强 高价值专利培育, 构建云网融合的新型算力设施, 统筹建设面向区块 链和人工智能等的算力和算法中心
2021.12	国务院	《"十四五"数字经济发展规 划》	推动智能计算中心有序发展, 打造智能算力、通用算力和开发平台一体化的新型智能基础设施, 面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域, 提供体系化的人工智能服务
2022.1	国务院	The state of the s	鼓励各地区各部门推进数据基础能力建设,积极构建数据安全存储、数据存证、隐私计算等支撑体系,推动大数据挖掘分析、智能计算、数据安全与隐私保护等核心技术攻关
2022.8	科技部、财政部	《企业技术创新能力提升行动方案(2022-2023年)》	推动国家超算中心、智能计算中心等面向企业提供低成本算力服务
2022.11	国务院	《关于数字经济发展情况的 报告》	算力基础设施达到世界领先水平,建成一批国家新一代人工智能公共 算力开放创新平台,以低成本算力服务支撑中小企业发展需求
2023.2	中共中央 国务院	《数字中国建设整体布局规划》	系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理 梯次布局
2024.9	工信部等十一个部门		优化布局算力基础设施,引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署,逐步提升智能算力占比,东部发达地区先行先试,探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式,西部地区在综合成本优势明显地区合理布局重大算力设施,探索建设超大型人工智能训练算力设施
2024.11	工业和信息化部等十二部门	《5G 規模化应用"扬帆" 行 动升级方案》	大力推进 5G 行业虚拟专网在工业、能源、医疗、教育等领域规模部署,带动云平台、边缘计算节点、智算基础设施等建设,发挥公网切片、网元下沉等技术能力,增强定制化服务水平,满足行业低成本、高安全应用需求
2024.12	国家发展改革委等部门	《关于促进数据产业高质量 发展的指导意见》	发展通算、智算、超算等多元化算力资源,支持企业参与算力全产业 链生态建设,构建一体化高质量算力供给体系
2025.2	工信部和信息化部等八部门	《新型储能制造业高质量发展行动方案》	面向数据中心、智算中心、通信基站等供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户, 推动配置新型储能

资料来源:中国政府网,工信部,发改委等,天风证券研究所



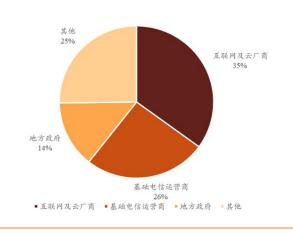
在大模型发展热潮带来的需求推动下,智算中心市场规模持续扩大。根据科智咨询测算,2023-2028 中国智算中心市场规模年化增速超 25%,2028 年市场规模超过 2800 亿元。根据《中国智算中心发展白皮书》(2024年),截至2024年8月,中国智算中心项目超 300个,已公布算力规模超 50万 PFlops。结构上,按算力规模来看,互联网及云厂商占据重要地位,其占比约 35%,其次为基础电信运营商,占比约 26%,地方政府则占比约 14%。

图 3: 在大模型发展热潮带来的需求推动下,智算中心市场规模持续扩大



资料来源:《中国智算中心发展白皮书》(2024年),科智咨询,天风证券研究所

图 4:按算力规模来看,互联网及云厂商占据重要地位,其占比约 35%,其次为基础电信运营商,占比约 26%,地方政府则占比约 14%



资料来源:《中国智算中心发展白皮书》(2024年),科智咨询,天风证券研究所

智算中心建设主体多样,功能诉求有别。政府主导的智算中心助力地方大模型研发与领域数字化,推动产业等智能化,优势是政策资金,短板是 IT 技术运营 ;基础电信运营商的智算中心补充政府算力基建,同时满足自身及业务拓展需求,资金技术客户资源足,但大模型存在竞争问题 。云厂商具有完善的供应链资源、技术能力强且客户资源丰富,出于集团 AI 业务发展需求及云业务扩展需求建设智算中心。第三方 IDC 服务商为业务增长布局,机房资源丰富但缺供应链和算力客户。服务器等厂商为纵向一体化,硬件资源获取强但 IDC 运营弱。

图 5: 智算中心建设主体多样,功能诉求有别

主体	战略目标	优劣势	代表案例
地方政府	响应国家战略,推动政策落 地;促进区域产业发展	优势: 政策、资金、产业园区客户 劣势: 缺乏 IT 技术、供应链经验、运营能力不足	北京、上海、广州等 30 多个城市
互联网及云厂商、基础电 信运营商	满足自身大模型训练需求; 拓展算力业务	优势: 充足的资金、技术和客户资源, 丰富的软件供应链资源, 较成熟的云算力业务模式 劣势: 自有大模型与大模型训练客户形成竞争互斥	腾讯合肥智算中心、中日 电信武清智算中心等
第三方 IDC 服务商	寻求业务增长	优势: 丰富的 IDC 机房资源, IDC 一体化建设运营能力 劣势: 缺乏 IT 供应链资源和算力客户	润泽国际信息港 A - 11 云数据中心、博大数据沿 圳前海智算中心
服务器厂商 / 芯片渠道 商	纵向一体化	优势: AI 芯片、服务器等硬件资源获取能力 劣势: 缺乏 IDC 供应链和机房建设运营能力	协鑫智算(上海)中心、 浪潮新疆克拉玛依智算。 心
AI 企业、应用企业	纵向一体化	优势: 算法及相关软件能力, 客户资源和应用场景积累 劣势: 缺乏 AI 芯片货源、IDC 资源	商汤临港 AIDC、理想汽车智算中心、小鹏 "扶摇" 智算中心
跨界企业	战略转型 / 发展新业务	优势:一般与芯片厂商、渠道商合作,获得芯片货源 劣势: 缺乏 IDC 资源和持续稳定的客户	英博数科北京 AI 创新 能中心、威星智能贵安 算中心、恒润股份芜湖 算中心

资料来源:《中国智算中心发展白皮书》(2024年),科智咨询,天风证券研究所



智算中心以多层次服务体系覆盖全产业链需求,形成四大核心商业模式:

laaS(基础设施即服务):提供机房托管和算力租赁,供应商包括数据中心服务商及中立智算中心,需求方为头部云商及 AI 公司、大型央国企、中小型科技公司、IT 公司、非连续需求的科研机构等;

PaaS (平台即服务): 头部 IT 公司提供 AI 开发工具链, 赋能中小企业快速构建 AI 应用;

SaaS (软件即服务): 垂直行业头部企业输出标准化 AI 应用,满足小型企业智能化需求;

MaaS (模型即服务): 成熟大模型供应商基于客户需求定制精调行业模型,服务中小垂直领域企业。

图 6: 智算中心以多层次服务体系覆盖全产业链需求,形成四大核心商业模式

类型	商业模式	介绍	供应方	需求方
laaS (基础设施即服务)	机房托管服务	在传统数据中心机房托管基础 上,提供更高功耗、配电和网 络定制	智算转型的数据中心服务 商、中立的智算中心服务 商等	头部云商及 AI 公司、 大型央国企等
laaS (基础设施即服务)	算力租赁服务	以云服务形式租赁智能算力, 按使用时间和规模收费	云厂转型的智算服务商、 中立的智算中心服务商等	中小型科技公司、IT 公司、非连续需求的科 研机构等
PaaS(平台即服务)	AI 平台服务	提供人工智能应用开发工具和平台	头部 IT 公司	中小企业和开发者
SaaS(软件即服务)	AI 应用服务	直接应用于企业业务, 提供人工智能分析、决策等服务	具有 AI 能力的垂直行业 头部企业	小型垂直行业企业
MaaS(模型即服务)	模型定制服务	模型定制、精调、部署等 AI 大模型全流程服务	成熟的大模型供应商(具有 AI 大模型技术能力)	中小垂直行业企业

资料来源:《中国智算中心发展白皮书》(2024年),科智咨询,天风证券研究所

2. AIDC 行情复盘: 从新基建政策红利到 AI 竞争带来的需求兑现

AIDC 为算力基建的核心载体,在 2018-2025 年间呈现三轮显著超额收益行情:

政策驱动阶段(2019.1.3-2020.7.14): 此轮行情核心催化来自于国家新型基础设施建设的体系化推进,算力基础设施累计涨跌幅+110%,相对全 A 涨跌幅+41%。2018年底中央经济工作会议首次将人工智能纳入新基建范畴,明确"加快 5G 商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设";2019年全国两会上,政府工作报告专项强调扩大新基建投资规模;2020年3月中央政治局会议指出"加快数据中心等新基建建设速度"。

技术政策共振阶段(2022.10.20-2023.4.25)。此轮行情核心催化来自于 AI 技术突破和政策共振,算力基础设施累计涨跌幅+50%,相对全 A 涨跌幅+39%。2022 年 10 月,美国限制对中国算力芯片出口,加速国产替代进程;2022 年 11 月,OpenAI 发布 ChatGPT-3.5,催生模型训练需求;2023 年 2 月,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,《规划》指出"夯实数字基础设施和数据资源体系'两大基础'"。

AI 大模型迭代突破阶段(2024.2.5-2025.2.26)。此轮行情核心催化来自于大模型的激烈竞争带来的算力需求显著提升。2024年2月,OpenAI发布视频生成模型Sora,视频生成模型相对文本模型对算力提出了更高的要求,2024年整年,国内互联网争相更新自己的模型,如24年3月 KIMI发布能处理200万字上下文能力大大模型,同年6月快手发布视频生成模型可灵。大模型的每次更新训练需要大量的算力资源,刺激了AIDC的需求。2025年1月,DeepSeek-RI版本发布,对标ChatGPT-o1模型,且用更好的算法减少了对算力门槛,也使国内芯片更加适配AI模型的训练和推理,加快国产替代进程。



图 7: AIDC 在 2018-2025 年间呈现三轮显著超额收益行情



资料来源:中国政府网,商务部,经济观察报,雷科技公众号等,天风证券研究所



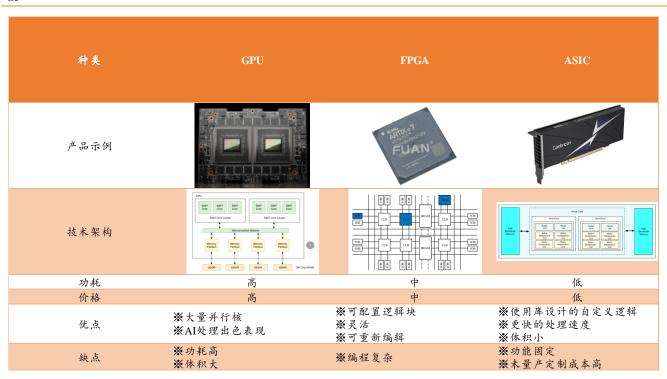
3. AIDC 产业链全景图谱

3.1. AI 计算芯片: GPU 主导 AI 计算芯片市场,国产替代加速

在人工智能计算芯片领域,主要技术架构可划分为图形处理器(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)三大类别。GPU 作为通用型并行计算核心,凭借高度并行架构,不仅在图形渲染领域保持技术优势,更在深度学习训练等高性能计算场景中展现出出色的吞吐能力。FPGA 是硬件可编程半导体器件,具有高度并行、高吞吐量、低功耗和可重构等特点,成为在实现深度学习算法的系统中提高性能功耗比的重要器件。通过可重构逻辑单元阵列实现算法与硬件的动态适配,其低延迟特性在实时推理、通信信号处理等场景具备独特优势。ASIC 是针对特定用途定制的集成电路,与通用集成电路如 CPU、FPGA 等相比,更能按照应用需求设计并实现特定功能。其针对特定算法进行全定制设计,在能效比指标上显著优于通用芯片。

从产业规模维度观察,GPU 当前占据中国 AI 计算芯片的主导地位,市场份额高达约 90%。根据中商产业研究院测算,2025 年我国 GPU 市场规模预计突破 1200 亿元。历史增速数据显示,三大芯片品类近五年复合增长率均超过 10%,其中 GPU 市场在 2024 年前维持 30%以上的年增速,至 2025 年增速预期回落至 10%-15%区间。在美国对华高端计算芯片出口管制持续升级与国内人工智能产业快速发展的双重驱动下,国产计算芯片产业正迎来战略性发展机遇。

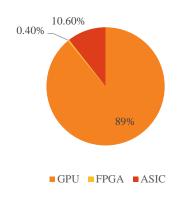
图 8: 在人工智能计算芯片领域,主要技术架构可划分为图形处理器(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)三大类别



资料来源:Ashutosh Mishra《Artificial Intelligence and Hardware Accelerators》,NVIDIA 官网,AMD 官网,寒武纪官网,偲睿咨询,36氪,智见 Time,腾讯技术工程公众号,Li Liang《An experimental evaluation of extreme learning machines on several hardware devices》。Google cloud,天风证券研究所

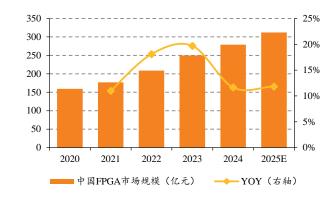


图 9: GPU 主导中国 AI 计算芯片市场



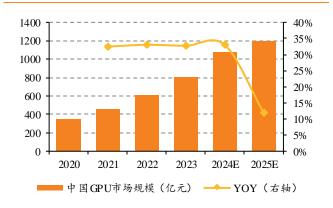
资料来源:中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 11: 2025 年中国 FPGA 市场规模预计超 300 亿元



资料来源:中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 10: 2025年中国 GPU 市场规模约 1200 亿元



资料来源:中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 12: 2025 年中国 ASIC 市场规模预计超 20 亿美元



资料来源: QYResearch 公众号, 天风证券研究所

图 13: AI 计算芯片: GPU 主导 AI 计算芯片市场,国产替代加速

细分领域	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主管产品名称	市值(亿元)
	688256. SH	寒武纪-U	658. 60	2. 89	227. 84	Cambricon Neumarekt并开发平台,果美纪核处理器、寒麦纪H校理器、寒麦纪M校理器、加速卡、思元100 (MLU100) 芯片及云 满智能加速卡、思元220 (MLU20) 芯片及这缘智能加速卡、思元270 (MLU270) 芯片及云端智能加速卡、思元290 (MLU290) 芯片 及云端智能加速卡、训练整机、云端智能芯片	2, 749
GPU	688981. SH	中芯国际	82. 90	0. 65	126. 68	光掩模制造、集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、凸块加工及测试	3, 954
	688041. SH	海光信息	136. 13	1. 34	101.45	海光3000系列、海光5000系列、海光7000系列、海光8000系列、通用处理器-海光CPU、协处理器-海光DCU	3, 164
	300474. SZ	景嘉徽	65. 35	0. 16	407. 93	图形显控、小型专用化雷达领域核心模块、芯片领域产品	342
	688047. SH	龙芯中科	120. 40	-0. 33	-360.80	龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号	483
	688107. SH	安路科技	25. 94	-0. 49	-52. 88	FPGA产品、FPGA芯片、专用EDA软件	104
	688385. SH	复旦微电	46. 30	0. 98	47. 20	FPGA芯片、安全与识别芯片、非挥发存储器、集成电路测试服务、智能电表芯片	319
FPGA	002049. SZ	紫光国微	63. 08	2. 02	31. 25	ASIC/SoPC、DRAM存储器芯片、IGBT、IGTO、POS 机安全芯片、SIM 卡芯片、THD88芯片、Titan系列可编程系统芯片(FPGA)产品 PGT180H、USB-Key主控芯片、第二代可编程系统集成芯片(SoPC)产品、电子证照芯片、非接触读写器芯片、高压超结MOSFET、 金融 IC 卡芯片、蓝宝石村成材料、石英晶体元器件、特种存储器、特种电源管理、特种接口驱动、特种可编程器件、特种微处理器、特种总线	536
4010	688220. SH	翱捷科技-U	78. 00	-0. 79	-98. 45	半导体IP授权服务、非蜂窝物联网芯片、蜂窝基带芯片、基带通信芯片、芯片定制服务、移动智能终端芯片	326
ASIC	688521. SH	芯原股份	82. 36	-0. 21	-391. 26	半导体IP授权服务、一站式芯片定制服务	413

资料来源: Wind, 天风证券研究所

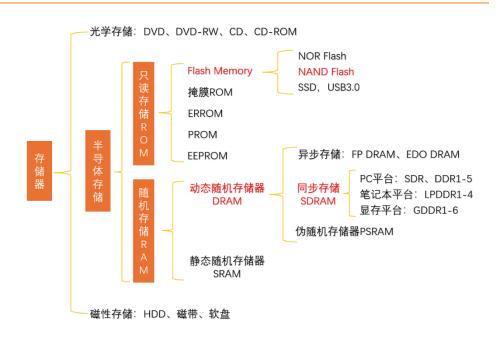


3.2. 存储芯片: 支撑数据存算协同的核心硬件, 技术升级与国产化替代进行时

存储芯片包括易失性存储和非易失性存储两大类,DRAM 与 NAND 闪存构成存储芯片的 "双支柱"。存储芯片按照是否需要持续通电以维持数据分为易失性存储和非易失性存储 两大类。易失性存储芯片以 SRAM (静态随机存储器)和 DRAM (动态随机存储器)为主:SRAM 凭借纳秒级存取速度和低存储密度特性,主要用于 CPU 与主存之间的高速缓存,承担指令与数据的临时存储功能;DRAM则在速度与容量之间实现平衡,其纳秒级访问速度与 GB 级容量特性使其成为设备运行时程序与数据暂存的核心内存。非易失性存储芯片以NAND 闪存和 NOR 闪存为代表。Flash 具有非易失性且存储容量大的特点,常用作系统程序和文件的存储。NOR-Flash 读取速度比 NAND-Flash 快,主要用于程序存储。NAND-Flash由于单位存储成本极低常用于数据存储。从市场格局看,根据中商产业研究院数据,DRAM与NAND 闪存构成存储芯片的"双支柱",两者合计占据全球存储市场绝大多数份额。

算力基建加速拉动存储芯片需求,技术升级与国产化替代催生投资机遇。2023 年受消费电子需求疲软及行业库存调整影响,DRAM 与 NAND 市场规模均处于周期底部。随着 AI 大模型训练对高带宽存储的需求激增,叠加智能终端边缘推理对高容量存储的拉动,DRAM 与 NAND 市场进入复苏通道。根据 CFM 闪存市场与中商产业研究所预测,DRAM 与 NAND 市场规模 24 年增速将回暖。我们认为在 AI 算力基建加速落地的背景下,存储芯片作为支撑数据存算协同的核心硬件,其技术升级与国产化替代已成为关键投资主线。

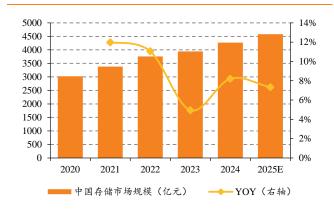
图 14: 存储芯片包括易失性存储和非易失性存储两大类,DRAM 与 NAND 闪存构成存储芯片的 "双支柱"



资料来源: 乐晴智库精选公众号, 行行查, 天风证券研究所

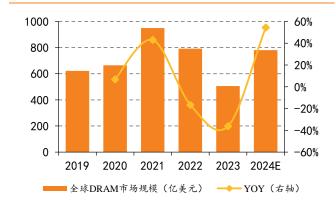


图 15: 24-25 年中国存储市场规模增速将回暖



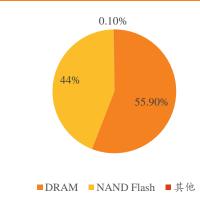
资料来源:中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 17: 预计 24 年全球 DRAM 市场规模增速回暖



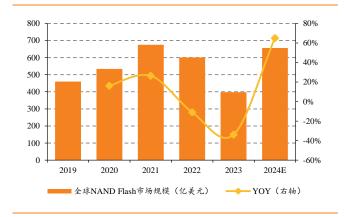
资料来源: CFM 闪存,中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 16: 存储芯片市场以 DRAM 和 NAND 为主



资料来源:中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 18: 预计 24 年全球 NAND Flash 市场规模增速回暖



资料来源: CFM 闪存,中商产业研究院公众号,天风证券研究所

图 19: 存储芯片: 支撑数据存算协同的核心硬件,技术升级与国产化替代进行时

细分领域	股票代码	股票简称	殿价	2025EP8 (元)	2025PE	主营产品名称	市值(亿元)
	603986. SH	兆易创新	115. 40	2. 38	48. 40	NAND Flash、NOR Flash、触控芯片、动态随机存取存储器(DRAM)、闪存芯片、指纹识别芯片	76
存储芯片	300223. SZ	北京君正	64. 62	1. 07	60. 44	Android 2.2第三方开发环境、USB Boot工具、XBurst CPU、存储芯片、互联芯片、计算芯片、君正Linux系统、模拟芯片、芯片	31
	688008. SH	澜起科技	76. 59	1. 92	39. 87	OKD达片、DDR2高板内希核冲器芯片、DDR3等有核冲器芯片(1.5V/1.3SV)、DDR3等存核冲器芯片(1.5V/1.3SV/1.2SV)、DDR3内 存核冲器芯片、MXC芯片、PCIe Retimer芯片、标准版混合安全內存模组(HSDIMM)第二代(Gen2)DDR4等有时钟驱动器芯片、 第二代(Gen2)DDR4数据技冲器芯片、第二代(Gen2 Plus)DDR4等存时钟驱动器芯片、第二代(Gen2 Plus)DDR4数接接冲器 芯片、第一代(Gen1)DDR4营存时钟驱动器芯片、第一代(Gen1)DDR4数据接冲器芯片、混合安全内存模组(HSDIMM)、津速* CPU、津速服务器CPU、精商瓶混合安全内存模组(HSDIMM—Lite)、内存接口芯片(含MRCD/MDB芯片)、内存模组配套芯片、消费 电子芯片	87
	301308. SZ	江波龙	73. 14	1. 66	44. 14	固态硬盘、内存条、嵌入式存储、移动存储	304
	000021. SZ	深科技	17. 39	0. 80	21. 65	病毒检测仪、超纯电容模组、升印机、呼吸机、扫地机器人、血糖仪、硬盘艇头、长城开发2.5英于硬盘头堆、长城开发3.5英寸台式电脑头堆、长城开发3.5英寸台式电脑头堆、长城开发6.4英寸。 成长城开发形成。 1. 大城开发移动硬盘、长城开发硬盘盘片、智慧冬芳寸量系统、智能电表、智能墨水平板	271
	688525. SH	佰维存储	58. 12	1.18	49. 33	Acertä	268
	688110. SH	东芯股份	32. 92	-0.04	-749. 89	DRAM、MCP、NAND Flash、NOR Flash、技术服务	140
	001309. SZ	德明利	111. 23	3. 45	32. 28	触控芯片、存储晶圆销售、存储卡模组、存储盘模组、固态硬盘、固态硬盘模组、内存条、嵌入式存储、闪存主控芯片、移动存储	180
	688766, SH	善冉股份	80. 48	3, 21	25. 09	FEPROM, NORFlash	85

资料来源: Wind, 天风证券研究所



3.3. 供配电: AI 算力需求激增驱动电源设备升级机遇

供电系统是数据中心的关键性基础设施,相当于数据中心的"心脏"。供配电系统一旦发生故障,不仅会导致数据存储和读取异常,还可能引发服务器宕机,造成数据丢失或损坏。系统正常运行时,市电通过双电源转换开关,经输入柜断路器接入UPS系统,再通过UPS输出并列柜输送至配电输出柜,最终为数据机房的机柜电源插座(Power Distribution Unit,PDU)供电。当电源故障发生时,柴油发电机立即启动,其输出的应急电源同样通过双电源转换开关,经输入柜断路器接入UPS系统,再经由UPS输出并列柜配送至配电输出柜为PDU供电。在柴油发电机电源尚未就位期间,由UPS系统为数据机房提供不间断电源,其蓄电池的备用供电时间不少于15分钟。

AI 算力需求激增倒逼智算中心供配电系统向集约化、模块化和预制化发展,驱动电源设备升级机遇。随着超大规模预训练模型的出现和快速迭代,智算基础设施的电力成本和设备成本均显著增加。使用英伟达 GPU 集群组成的微软超算数据中心中训练一次 GPT-3 模型消耗的电量约为 19 万度。大型智算基础设施耗电量更大,以 10 万 GPU 集群为例,功率超过 150MW,一年的耗电量近 16 亿度(来源:中国信息通信研究院)。传统的数据中心供配电系统在全新的时代需求下,已经逐渐显现出结构过于庞杂,安装以及运维难度大,交付周期长,能源损耗占比高,占地空间大等系列瓶颈。未来,数据中心电源产品系统开始朝集约化、模块化、预制化方向发展。可关注机柜外电源,柴油发电机,备用电源,变压器等细分领域。

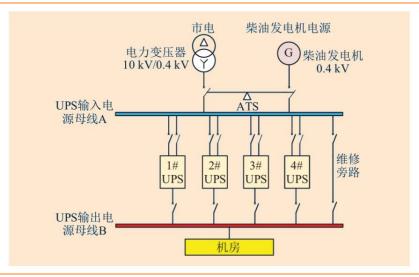


图 20: 数据中心供配电系统示意图

资料来源:王继业《数据中心关键技术和发展趋势研究综述》,天风证券研究所



图 21: 供配电: AI 算力需求激增驱动电源设备升级机遇

细分领域	股票代码	股票简称	股价	2025EP8 (元)	2025PE	主管产品名称	市值 (亿元)
UPS	002335. SZ	科华数据	38. 37	1. 29	29. 67	1500V S*液冷储能系统、3kW-6.9kM 储能变流器、3kW-9kM 光伏逆变器、6-GFW系列蓄电池、DL31系列UPS、DLG系列UPS、DR系列 电梯可能装置、EMS 智慧管理平仓、FL系列电源防雷焰、FR-UK-平系列电源、FR-UK系列UPS、IT机产等解决方案、比系列UPS、 MRMM—2省能免验管理系统、MR系列工业或模块化UPS、电力计业解决方案、调核行业解决方案、工商业能能系统、工业用FR-UK-FG 系列UPS、户用光储系统、科华 Wise MDC 系列液冷微模块、三进单出FR-UK系列UPS、三进三出FR-UK系列UPS、水泥行业电源解决方案、通信用分布式UPS、通信用在线从下间断电源DXR系列UPS、通信用正弦波逆变器DJM系列UPS、小卫士系列UPS、流浪化工企业解决方案、调查检查业务。	198
	002518. SZ	科士达	22. 03	1. 04	21. 21	不间断电源 (UPS) 、动力环境监控等设备和系统、高压直流电源、精密空调、精密配电、通信电源、网络服务器机柜、蓄电池	128
	002364. SZ	中恒电气	16. 10	=	-	240V/336V 直流关键电源、5G-Smart模块化电源系统、5G站点一体化能源柜、5G智慧储能系统、HVDC、UPS、大功率充电系统、大功率电源系统、电力模组-HG 系列。电力模组-H 系列、电力模组-P 系列。电力通信电源、二轮换电、国内直流电源产品。国外直流电源产品、交流供配电源、精密配电、宝外小型一体化电源、其力电源、有序交流充电系统、直流一体式充电系统、智能光伏、智能矩电、智能微模块、智能液冷整机柜、智能一体化电源	91
HVDC	603063. SH	未望电气	30. 36	1. 39	21. 80	1000V于变一体机、1000V油变一体机、1500V+变一体机、1500V油变一体机、300V全动电变温器、690V风冷处划喷淀温器、690V模块化全动单变温器、690V从冷水均变温器、690V/1140V及冷水喷淀温器、900V/1140V及冷水喷淀温器、950V/1140V及冷水喷淀温器、102V间分、142V间水冷水水喷流温器、124+输液溶制氢可岩管理系统、hopePrive系列工程型变频器、hopePrit系列变频器。1027000)。10250的自由无动发生表置、变荣控制系统、储能变流器、依电压字超模拟系统、依住工程型单轴/多轴变频器(1027000)。202 从上企业性模拟系统、高性能低压失量变频器(NM500)、工程型中压变频器(NB0000)、202 从并问题变换,与定型制度和重要分量。 202 集中式进变器、起变于用变频器(NM500)、指装式均32-作制载装置、全动率型风电变流器、双喷型电变流器、通可器使低压重频器(NM500)。这程制能能使压力模型,202 电电子系统、加速分离性电力电频器(M500)。这程制能能使压力模型,202 电电子系统、加速分离性电子系统、加速分离性电子系统、加速分离性电力和电力。	138
机柜内电源	002843. SZ	泰嘉股份	23. 00	0. 46	49. 91	高速钢带锯条、硬质合金带锯条	58
(AI 服务器	002851. SZ	麦格米特	44. 45	1. 39	31.90	电源产品、工业自动化、精密连接、新能源及轨道交通部件、智能家电电控产品、智能装备	243
电源)	300870. SZ	欧陆通	104. 00	3. 01	34. 61	电源适配器、服务器电源、其他电源	111
	000880. SZ	潍柴重机	32. 28	0. 98	32. 81	柴油机零部件、船用齿轮箱配套、电力集成系统、动力集成系统、发电机组、游樂170系列中速机、游樂6160系列中速机、游樂6170系列中速机、游樂8170系列中速和、游樂8170系列中速和	107
柴油发电机	300153. SZ	科泰电源	26. 94	-	-	KU系列电站、KU大功率系列电站、KM小功率系列电站、KP系列电站、KS系列电站、KV系列电站、车载电站、电动电缆绞盘、方舱电站、挂车电站、机房降噪工程、机组冷却系统改造、机组自动化电脑监控系统升级、静音型电站、控制系统、通讯基站用电站、油田用电泳、适置水路、自动并生系线。自动动接系线、	86
	600590, SH	泰豪科技	8, 49	-	-	IT运维及系统集成、军用电源装备、军用通信装备、配电设备、智能应急电源	72
	300014. SZ	亿纬锂能	47. 20	2. 56	18. 45	储能电池、动力电池、亿纬锂能锂离于及锂聚合物组合电池、亿纬锂能锂锰电池、亿纬锂能锂亚电池、亿纬锂能镍氦组合电池	966
	002245. SZ	蔚蓝锂芯	12. 40	0.60	20. 66	LED 产品、金属物流配送业务、锂电池业务	143
备用电源 BBU	688226. SH	威騰电气	26. 98	1. 07	25. 27	GFII系列高压共稻封闭母线、GH-D系列低压树脂母线、GH-N系列对次母线、GH-Z系列中压树脂母线、KYN28A-12户内交流企属封闭 开关设备、KYM61-40.5户内交流金属封闭开关备、LEO系列需集型生投槽、LM系列需集型生投槽、LV系列需集型生投槽、MLS-V交 流低压成套开关设备、MMSH交流低压成套开关设备、PV12-12户内交流金属封闭开关设备、P230照明箱、OLFM系列高相封闭母线、 ML6系列复合绝接管型风电母线、ML系列风电母线槽、XL动力配电枢、XTM配电稻、光度快带、铜铅材	51
	002922. SZ	伊戈尔	15. 40	0. 97	15. 81	E1壁变压器、LED原则电源、S010环囊浇注干米变压器、车载电源、车载电源、充电旅、储能装置、低压卤素力电源(电子变压器)、非晶干式变压器、高压铁芯串联电抗器、工业控制美环形变压器、加加,进入速度 港流用大力率变压器,光伏电站并所配塞用分裂变压器、旁观打电器箱、特殊用途干灰变压器、新能源汽车用高频变压器、移相变压器、整流变压器	60
变压器	688676. SH	金盘科技	31. 77	1. 73	18. 32	SVB、PPI干式变压器、VPI干式电抗器、VPI型移相整流重压器、抽水蓄能特种干式变压器、低压开关机。多晶柱还原炉用干式变压器、非晶合金变压器、风电风电力液浸式变压器、风力发电专用干式变压器、高端装备制造产业、轨道交通引整流变压器、轨道交通用大电流大开断充气机、海上平台专用变压器、海洋平台专用55k以之地流充气机、环网机、取其树脂浇注标准干或爱压器、环泉树脂浇注干式电抗器、环泉树脂浇注特种干式变压器、粗电专用爱压器、节能环保产业、配电液浸式变压器、氩化炉用转种变压器、三维立体参铁芯干水变压器、转种打压度压器、稍式变电站、新能源汽车,都能源汽车中。体化逆变并网装置、一体化道流充电站、集空压力浸渍特种干式变压器、中空压力浸渍干式电路器、集空压力浸渍特种干式变压器、中重推	146

资料来源: Wind, 天风证券研究所



3.4. 网络: 算力基建向多机多卡发展, 高性能网络决定通信效率

算力基础设施硬件架构向多机多卡发展,高性能网络决定集群通信效率。AI 模型正加速向 干亿至万亿级参数规模演进,其指数级增长的算力与显存需求对硬件架构提出更高要求。 为提升模型训练效率,多机多卡分布式训练技术已成为行业标配,而该技术的有效运行需构建具备超强计算与显存能力的集群作为硬件底座。在此架构中,联接算力节点的高性能 网络直接决定了集群通信效率,进而影响整体吞吐量和算力利用率。

当前大规模智算集群组网主要采用两类技术路线:

- 1. InfiniBand 网络: 凭借高带宽(主流 200G/400Gbps 已规模商用)、微秒级时延及无丢包特性, InfiniBand 成为大模型训练场景的首选方案,可最大程度避免 GPU 因数据等待导致的算力空转。但该技术受英伟达生态垄断,存在成本高、开放性不足等局限;
- 2. RoCEv2 网络:基于以太网的无损网络技术,在成本与兼容性方面更具优势,正加速向智算领域渗透,逐步探索对 InfiniBand 的替代可能。

与此同时,为突破单集群算力规模、电力供给与机房空间限制,行业正加速研发支持跨数据中心分布式训练的长距组网技术。可关注光通信&CPO、AEC&铜连接及交换机等领域。

图 22: 高性能网络需要具备低时延、高带宽、长期稳定性、大规模扩展性和可运维等关键能力

特性	内容
低延时	因通讯延时存在,分布式训练系统整体算力非随智算节点增加线性增长,加速比小于 1。通讯延时指单次计算中不同卡间通讯致数据通讯延迟,降低卡间通信时间是提升加速比关键
高帯寛	AI 大模型训练场景下,机内机外集合通信操作产生大量通信数据。流水线并行、数据并行及张量并行模式需不同通信操作,要求网络单端口高带宽、节点间可用链路数量多、网络总带宽高。计算节点计算需节点间快速同步,带宽不足会使梯度传输慢、卡间通信时长变长影响加速比
高稳定	AI 模型增大使计算量增大, 大規模训练持续數周甚至數月, 大量數据需 网络传输处理。网络不稳定会致数据传输中断、丢失或错误, 影响數据 分析和计算结果准确性, 网络稳定性保障数据传输完整性、准确性和及 时性
易扩展	AI 并行技术发展使大规模 AI 训练用上千乃至上万张 GPU, AI 业务发展对智算集群扩展性有要求,智算网络需在满足当前业务需求时预留应对未来新增需求能力
易运维	AIDC 网络运维综合性强,对于含成百上千张 GPU 卡的集群,将智算集群运行状态可视化、配置变更白屏化,快速感知异常状态和故障是高效运营基础

资料来源:超云 SuperCloud 公众号, AIDC 基础设施建设白皮书(2024年)-

超云&西云算力,天风证券研究所

图 23: InfiniBand 和 RoCE 网络解决方案特点对比

对比维度	InfiniBand	RoCE	
同集群端到端时延	2us	5us	
性能(时延、丢包等)	出色	好	
网络无损	完备	待规模工程验证	
稳定性	出色	好	
网络配置	通过 UFM 实现零配置	手工配置	
生态	封闭	开放	
建设成本	3 倍 +	低	
硬件	IB 交换机	以太网交换机	
产业生态	NVIDIA 独家	芯片: 博通/Marvell/NVIDIA/中兴/华 为/盛科 设备: Cisco/Arista/Juniper/中兴/ 华为/H3C/锐捷	

资料来源:超云 SuperCloud 公众号,AIDC 基础设施建设白皮书(2024年),

智算产业发展白皮书(2023),天风证券研究所



图 24: 网络: 算力基建向多机多卡发展,高性能网络决定通信效率

细分领域	股票代码	股票简称	股价	2025EPS (元)	2025PE	主營产品名称	市值 (亿元)
	002281. SZ	光迅科技	41. 22	1. 36	30. 29	16G FC光模块、32G FC光模块、400G ZR OSFP-DD DCO、400G ZR+ OSFP-DD DCO、4G LTE 和 5G 网络用 OPRI/eCPRI 的前传光妆发模块、从 1G 到 50G 各连率的 BOSA 和无准发模块、光讯科技光分复用器、光讯科技光流长板实种模器、光讯科技光集成器件、光讯科技光连接器、光讯科技光等成艺器、光讯科技光线路保护于系统、光讯科技光线接接器、大师科技光线路	327
	600487. SH	亨通光电	14. 88	1. 34	11. 08	亨通光电层绞式光缆、亨通光电电力光缆、亨通光电光电转换收发器、亨通光电光纤、亨通光电光纤带光缆、亨通光电交换机、 亨通光电气送光缆、亨通光电室内光缆、亨通光电特殊光缆、亨通光电中心束管式光缆	367
	688313. SH	仕佳光子	28. 70	0. 68	42. 47	10g DFB激光器芯片、2.5g DFB激光器芯片、AMG晶圆、AMG芯片、DFB激光器器件、PLC分路器晶圆、PLC分路器器件、PLC分路器器件 片、容观光纤连接器、单芯光观、多芯光缆、多芯束连接器、射频拉运光缆、室内光缆、数据中心AMG器件、无源芯片/器件、线 缆高分子排件、有源芯片/器件	132
	300570. SZ	太辰光	67. 77	1. 88	36. 07	AMG 芯片、MT 插芯、PLC 分路器、PLC 芯片、波分复用器、常规及高密度光纤连接器、光传感、光缆熔接箱、光模块、光纤配线机箱、光纤柔性板、陶瓷插芯、有源光缆(AOC)	154
	300394. SZ	天孚適信	74. 07	3. 66	20. 22	光收发接口组件、光纤适配器、陶瓷套管	411
	300502. SZ	新易盛	115. 93	8. 50	13. 63	8006/4006相干系列模块。CFP2 PAM4 200G、CFPx系列、OSFP 400G、OSFP 8006单流100G、OSFP 8006单流200G、OSFP-XD 1.6T、 PON光模块、OSFP112 400G、OSFP28 PAM4 50G、OSFP28 Single Lambda、OSFP26/OSFP+、OSFP56 PAM4 200G、OSFP-DD 200G、OSFP-DD 400G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流200G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 单流100G、OSFP-DD 800G 9流10G 0SFP-DD 800G 9流10G 9	822
	688498. SH	源杰科技	128. 04	1. 20	106. 75	1270/1290/1310/1330m未功率25/50/70mW 淮老层芯片、1270mm DFB激光层芯片、1310mm DFB激光层芯片、1310mm FP激光层芯片、 1.490mm DFB激光层芯片、1550mm DFB激光层芯片、CMDM 4波段 DFB激光层芯片、CMDM 6波段 DFB激光层芯片、LMDM 12波段 DFB 激光层芯片、LWDM 4波段 DFB激光层芯片、MWDM 12波段 DFB激光层芯片、PAM4 CMDM 4波段DFB激光层芯片	110
光通信 & CPO	601869. SH	长飞光纤	32. 33	1. 35	24. 03	50/125 山市绿光纤、62.5/125 山市餐提料、8平35/扩套光缆、A扩套侧丝的瓷光缆、A扩套风色侧、斜扩套风色侧带锁控管光缆、标子放向邻邻花界比等光缆、标户套光缆、层砂模构经的瓷板、排音表缆、A扩套风色铜帘镜架比许参光缆、标户表光电落仓螺、S扩套光缆、外容表现包邻邻花界比许表现。标论分析度自承式光缆、层线式补扩条光线、标设从10/04/2/014/3/014/45 电对电子模型 电电子电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影	180
	688048. SH	长光华芯	52. 36	0. 13	406. 84	DPB系列、BML系列、SL系列、TOF系列、VCSEL系列、VCSEL芯片-PS系列、VCSEL芯片-SL系列、VCSEL芯片-TOF系列、百瓦颇直接半 字体激光思-DDLM系列、高功率电条器件、高功率电条芯片、高功率单管器件、高功率单管器件一TO系列、高功率单管器件、高功率 列、高功率单管芯片、高功率直接半导体激光器-DDLF系列、高光度直接半导体激光器-DDLV系列、无遗信芯片系列产品、光纤解 合模块、光纤耦合模块-F系列、光纤耦合模块-M系列、激光雷达ELL系列、激光雷达UR系列、数百瓦直接半导体激光器-DDLM系列 , 阵列模块、阵列模块-MCP-V、VQ系列、阵列模块-QCP-M系列、阵列模块-QCP-V系列、直接半导体激光器、中功率直接半导体激 光器-DDLF系列	92
	300308. SZ	中际旭创	91.87	7. 35	12. 49	1.6T OSFP, 100G QSFP+, 100G QSFP28 Single Lambda, 10G SFP+ Ethernet, 10G SFP+ SONET, 25G SFP28, 400G OSFP, 400G QSFP-DD, 40G QSFP+, 800G OSFP, 800G QSFP-DD	1015
	600522. SH	中天科技	13. 20	1. 09	12. 12	中天RF电缆、中天电力光缆、中天光缆、中天光纤带光缆、中天海缆、中天铝包钢绞线、中天铝杆和电力导线、中天普通光缆	451
	300548. SZ	博创科技	46. 41	0. 68	68. 59	PLC光分路器、PON光模块、高速光电模组组件、高速模拟芯片、光纤阵列、密集波分复用器件、数通高速铜缆(DAC、ACC)、数通光收发模块、数通无源预端接跳线、数通有源光缆(AOC)、无线承载网光收发模块、消费及工业有源光缆	134
	688668. SH	鼎通科技	47. 36	1. 45	32. 66	1/0连接器及其组件、电控连接器、高速背板连接器及其组件、高压互锁连接器、高压连接器、控制系统连接器及其组件、汽车连接器组件、通讯连接器组件	66
	688629. SH	华半科技	50. 60	0. 54	93. 60	BDU/PDU充配电系统总成、电气车钩总成、电源类连接器、防务连接器、高速连接器、高压线束、光通讯连接器、轨道交通连接器 、射频类连接器、系统互连产品、线缆组件、印制板连接器、组件	233
AEC & 铜连接	688800. SH	瑞可达	52. 30	1. 57	33. 21	SG系世級ASSIVE MIMO核耐板斜侧直接连接器。GG通信在前坐卫星领域的PSUP,斜桁组件及墨来波走接器产品。REG系列产品。CSS FARPA、RISB高速,mini-FARRA、SUP型连接器。 文章标准等功高速连接器,超克系统。超克系统。超克系统,超克系统。是不够连接器。 车钩连接器、车钩连接器、车缆板Type C接口、车载多千兆以太网连接器、充电组、储能连接器、低空飞行器的高低压连接器。 战者组件、低压连接器。 电池连接系统、电子导射、高速10连接器。 高速放射放连接器。 局正大电流连接器及归降,高压焦束、工业连接器、换电速接器、交直流走电路、内窥镜、端可运传输交换器。向电流的电连接器、踢可运传输交换器将通线器。 场对连接数分操光信号的光速接器。 场可运传输交换微波的微波射频连接器。 特别消除、手动维护开关、微波消除、无线基站的光电模按接头或接接器、液冷支电性。 医疗透接器 以太阳残失。 要提连接器	83
	300563. SZ	神宇股份	34. 30	-	-	半剛、半柔电缆、高端稳相电缆、高速数据线、极细射频同轴电缆、射频电缆组件定制化服务、微波低损耗电缆、细微同轴射频 电缆.	61
	002130. SZ	沃尔核材	19. 13	1. 03	18. 63	标识管、车内高压线束、充电座、电动汽车充电枪、高速通信线、高压电缆附件、高压连接器、工业线、国际交直流充电座、核 级电缆附件、可分离连接器、冷、热缩电缆附件、连续母排保护套管、汽车线、热缩管、双壁管、消费电子线	241
	002897. SZ	意华股份	38. 23	2. 01	18. 99	Battery Conn、FPC 连接器、HDMI、IEEE1394、PCI-e(NGFF)、Pogo Pin、FF 连接器、RJ45 网络变压器插座、RJ45、RJ1插头、SFP、SAS、USB、电源插座、电源连接器、平机轴孔、工业连接器、接线调子、企丝、纪金丝、汽车连接器、太阳能支架业务、天线德局器、网络变压器、网络模压器、Catbe、Catb、网络座低架、消费电子线条	74
	301165. SZ	锐捷网络	66. 00	1. 34	49. 34	SMB交换机、SMB无线接入点、场景化部署无线接入点、放装型无线接入点、路由器、数据中心交换机、无线管理与应用系统 (WIS)、无线控制器、园区与城域网交换机	375
	688702. SH	盛科通信-U	58. 03	-	-	Duet 2 系列芯片、E350/V350系列三层以太网交接机、E530/V530系列三层以太网交接机、E550/V550系列三层以太网交接机、 E580/V580系列三层以太网交接机、E680/V680系列三层以太网交接机、GoldenGate 系列芯片、GreatBelt 系列芯片、Humber 系 列芯片、TsingMa 系列芯片、TsingMa 服 系列芯片	238
交换机	000938. SZ	紫光股份	23. 70	0. 77	30. 72	存储产品、服务器、网络安全产品及服务、网络设备、云计算与云服务、智能终端、紫光IBM 11产品销售、紫光IP/4 / V6X模核 心路由器、紫光笔记本电脑、紫光耗材、紫光虹外测温仪、紫光患普17产品销售、紫光家用消毒机、紫光刻录光盘、紫光苹果IT 产品销售、紫光扫描仪、紫光数码相机、紫光台大色脑、紫光投影仪	678
	000063. SZ	中兴通讯	31. 20	1. 88	16. 58	中兴DSL终端,中兴刀片服务器,中兴多业务市点设备,中兴机聚服务器、中兴基站,中兴基础验系统、中兴计费标算系统、中兴家庭间关、中兴宽带网关、中兴宽带网络机顶盒、中兴路由交换机、中兴路由器、中兴经验电源、中兴手机、中兴通流终端&业务管理千台(2KGSM)系统、中兴网管系统、中兴小家量中继用关、中兴综合接入设备(14D)	1409
	301191. SZ	菲菱科思	73. 89	2. 04	36. 19	交換机、路由器及无线产品、適信设备组件	51

资料来源: Wind, 天风证券研究所



3.5. 制冷: 单机功率密度攀升驱动散热系统升级, 液冷技术有望成为数据中心的主要选择

我国算力中心规模保持高速增长,建设大型及以上算力中心成为主流模式。**而高算力需求进一步推动算力中心单机功率密度提升,**大型算力中心的单机架功率密度已接近8kW,少数超大型算力中心的单机架功率密度已达20kW。高功率的服务器和IT设备产生的热量不断增加,而算力中心的散热能力有限。因此,算力中心需要采用先进的散热技术,解决机柜间空气流动限制、散热设备容量不足、空间和布线限制等散热难题。(来源:中国信息通信研究院)

冷板式液冷路线占据主流,浸没式液冷路线有望逐步成为技术演进的主流方向。液冷技术通过液体介质替代空气散热,以直接接触方式实现设备高效降温,现已成为新型制冷方案的核心路径。液冷的技术架构由热捕获、热交换与冷源三大核心环节构成,基于热捕获方式的差异,当前主流方案分为冷板式、浸没式和喷淋式三类。其中冷板式技术凭借成熟度优势,已在高性能计算及高密度算力中心实现规模化应用,对降低 PUE 值和推动绿色低碳转型具有显著效益。根据中商产业研究院所述,冷板式液冷路线是目前成熟度最高、行业布局最多、应用最广泛的液冷散热方案之一,市场占比约为65%;而浸没式液冷凭借近100%的散热效率与成本优势,正逐步成为技术演进的主流方向。在"双碳"战略指引下,液冷技术通过节能增效正加速向算力基础设施渗透,可关注液冷相关供应商。

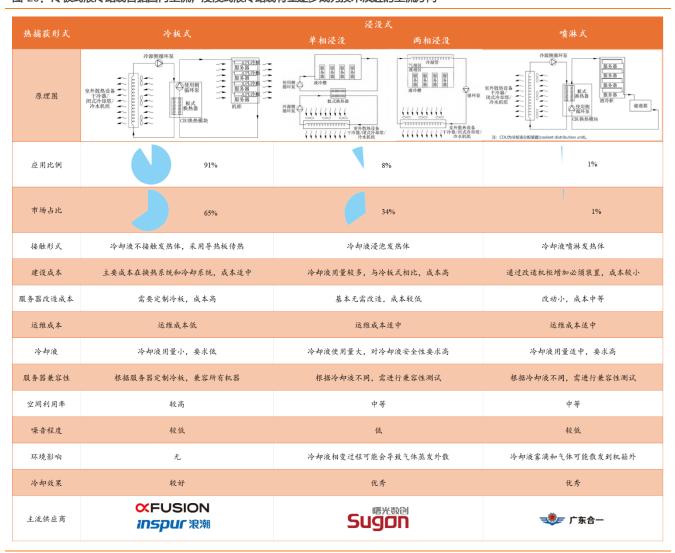


图 25:数据中心冷却方式

资料来源:科智咨询《中国液冷数据中心市场深度研究报告》,天风证券研究所



图 26: 冷板式液冷路线占据国内主流,浸没式液冷路线有望逐步成为技术演进的主流方向



资料来源:中商情报网,科智咨询,天风证券研究所

图 27: 制冷: 单机功率密度攀升驱动散热系统升级,液冷技术有望成为数据中心的主要选择

细分领域	股票代码	股票简称	股价	2025EP8 (元)	2025PE	主管产品名称	市值 (亿元)
	002837. SZ	英维克	31. 50	0.83	37. 74	轨道交通列车空调及服务、机房温控节能设备、机柜温控节能产品、客车空调、室外机柜温控节能设备、新能源车用空调	235
	300602. SZ	飞荣达	18. 64	0. 65	28. 60	EMI 胶带、GoF石墨村墊、HP-RTM电池包上盖、笔记本散热模组、充电器、储能液冷、囊化硼绝缘均热膜、导电布村垫&导电泡棉、导电油棉扁蕨膜、导电橡胶、导热界面材料、导热器件、电池模组漏板、电磁扁蕨器件、电源、镀金镀锡PI 村墊、风冷散热器、风扇、服务器数据中心、服务器液冷、光优逆变器分壳、基站天线、全属屏蔽件、纳米晶&砸性器件、纳米银线导电泡棉、其他电子产品、汽车电子液冷、热管/VC、石墨片、石墨烯膜、无线充电模组、吸波材料、相爱储能材料	108
	300499. SZ	高渊股份	16. 42	0. 18	89. 48	始水冷却设备的控制系统、大功率电气传动变频器纯水冷却设备及附件(电气传动水冷产品)、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备及附件(柔性交流水冷产品)、新能源发电变流器纯水冷却设备及附件(新能源发电水冷产品)、直流输电换流阀纯水冷却设备及附件(直流水冷产品)、	50
液冷	002335. SZ	科华数据	38. 37	1. 29	29. 67	15000 SP液冷储能系统、3kW-6.9MM 储能变速器、3kW-9MM 光优逆聚器。6—GFU系列蓄电池。DL31系列UPS、DLG系列UPS、DR系列 电梯节能装置、EMS 智慧管理平台、FL系列电源防需箱、FR-UK-P系列电源、FR-UK-P系列UPS、IT机房电源解决方案、比系列UPS、 MMMM-2常能色必管理系统、MR系列工业级模块化IPS、电力扩业解决方案、钢铁行业解决方案、工商业储能系统、工业用FR-UK-P系列UPS、中原于UK-P系列UPS、中原于UK-P级模块。一种单址FR-UK系列UPS、正建上出FR-UK系列UPS、水泥行业电源解决方案、通信行企电源解决方案、通信行分率式UPS、通信用在线式不同断电源DDB系列UPS、通信用正弦波逆变器DJM系列UPS、小卫士系列UPS、液象化工企业解决方案、智慧电能业务、智能化起小型组模式UPS	198
	301018. SZ	申菱环境	34. 52	1. 03	33. 46	VOOs治理特种设备、除湿机、低露点除湿机、飞机地面空调、核电抗震型风冷冷水机、恒温恒湿空调、机房专用空调、洁净空调、冷热水机组、污泥低温干化设备等环境调控设备、屋顶式空调、一体化蒸发冷却式冷水机组、专用性空调、组合式空气处理机	92
	300990. SZ	同飞股份	45. 18	1. 69	26. 73	• 此水冷却单元、电气箱恒温装置、特种换热器、液体恒温设备	77
	300017. SZ	网宿科技	10. 41	0. 30	34. 30	CDN服务、IDC及液冷解决方案、MSP服务、SASE办公安全一体化体系、WAAP全站防护体系、边缘计算、算力云、综合安全服务体系	255
	002126. SZ	银轮股份	26. 23	1. 30	20. 25	后处理排气系统、汽车空调等热管理产品、银轮EGR、银轮板翅式冷却器、银轮舒表式冷却器、银轮管翅式冷却器、银轮管光式冷却器、银轮机油冷却器、银轮冷却模块、银轮冷却器模块总成、银轮冷却器总成、银轮铝冷却器、银轮中冷器	219

资料来源: Wind, 天风证券研究所



4. 风险提示

- 1)产业发展进程不及预期:人工智能技术迭代期,若算法突破速度放缓或硬件配套供应受限,可能导致产业发展降速。
- 2)政策出台和落地具备不确定性:人工智能相关政策的出台和已出台政策的落地情况具备不确定性,若政策支持力度下降可能导致相关投资放缓。
- 3) 宏观经济波动:全球利率环境超预期变化或影响科技板块估值。



分析师声明

本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称"天风证券")。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
自报告日后的 6 个 股票投资评级		买入	预期股价相对收益 20%以上
	自报告日后的6个月内,相对同期沪	增持	预期股价相对收益 10%-20%
股票投资评级	深 300 指数的涨跌幅	持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
		买入 增持 持有	预期行业指数涨幅 5%以上
行业投资评级	自报告日后的6个月内,相对同期沪	中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
	深 300 指数的涨跌幅	—	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心B	海南省海口市美兰区国兴大	上海市虹口区北外滩国际	深圳市福田区益田路 5033 号
座 11 层	道3号互联网金融大厦	客运中心 6号楼 4层	平安金融中心 71 楼
邮编: 100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编: 200086	邮编: 518000
邮箱: research@tfzq.com	邮编: 570102	电话: (8621)-65055515	电话: (86755)-23915663
	电话: (0898)-65365390	传真: (8621)-61069806	传真: (86755)-82571995
	邮箱: research@tfzq.com	邮箱: research@tfzq.com	邮箱: research@tfzq.com